



免洗焊锡膏

特性:

- 减少枕窝瑕疵
- 兼容Rheopump 和 DEK ProFlow
- OSP上的空洞更少
- 减少葡萄球现象
- 强化精细间距印刷
- 高耐湿性

描述:

NC512 是一款被证明可以提供良好的活性和润湿特性的免清洗焊锡膏，它具有优异的抗塌落性，减少了 BGA 中的空洞。NC512 提供了高湿度的耐受性和用于空气中回流的化学性。发现在环境控制不佳时，NC512对塌落和湿度的高容忍度延展了焊锡膏在设备中使用寿命。NC512残留物可被引脚探针测试。

印刷:

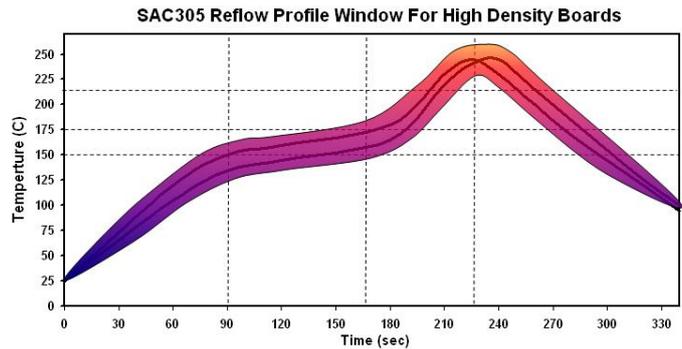
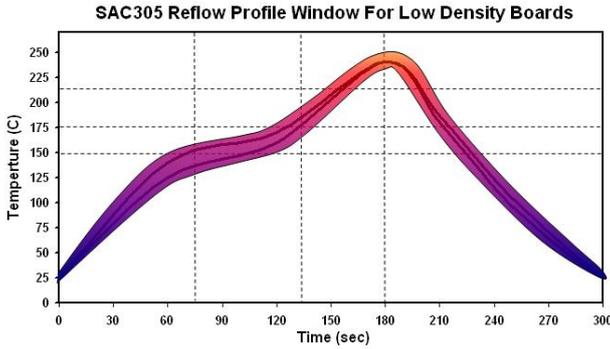
- 在丝网上施加足够的焊膏，以使其在循环印刷期间能产生平稳均匀的滚动效果。通常在滚动的直径为 12到16毫米 (1/2 到 5/8 英寸)时即可开始。
- 可以在一定的时间间隔向丝网上施加少量的新鲜焊膏，以保持焊膏的化学和使用性能。
- NC512可为当今的高速贴片设备提供足够的粘附时间和粘附力，从而提高产品的性能和可靠性。
- 丝网的清洗方式将随应用而变；不过，可采用 AIM DJAW -10 丝网清洗剂来完成。

以下印刷初始设置根据PCB和焊盘的设计提供

参数	建议初始设置	参数	建议初始设置
刮刀压力	0.9 - 1.5 磅/英寸每刀片	PCB 分离间距	0.75 - 2.0 毫米 (.030-.080")
刮刀速度	0.5 -英寸/秒	PCB 分离速度	3.0 - 20.00 毫米/分
脱模距离	接触 0.00 毫米 (0.00英寸)		

回流曲线:

两种典型回流曲线说明如下：他们既可用于 Ramp-Spike 也可用于 Ramp-Soak-Spike 应用,且回流温度相似。两个回流曲线的不同处在于它们达到各自的最高温度的位置，以及在液相线以上的时间(TAL)。短回流曲线图将适用于较小的组件,长回流曲线图适用于较大的组件,如背板或高密度板。阴影部分定义为工艺窗口。炉子的效率、板子尺寸/质量、元器件类型和密度都影响某一指定组件的最终回流曲线。这两个曲线图作为起始推荐，建议使用附有热电偶的实装板进行工艺优化。



升温斜率最大2°C / 秒	升温到150°C (302°F) 所需时间	150°C-175°C (302°F-347°F) 之间时间	230°C-245°C (445°F-474°F) 到峰值时间	217°C (425°F) 温度以上	冷却速度≤ 4 °C / SEC	冷却时间
Short Profiles	≤ 60 Sec	15-45 Sec	45-75 Sec	45-60 Sec	45± 15 Sec	2.75-3.75 Min
Long Profiles	≤ 90 Sec	60-90 Sec	45-60 Sec	45-75 Sec	45± 15 Sec	4.0-5.0 Min

❖ 推荐的回流曲线只作为一种指导，需要根据炉子类型，组件以及其他的工艺进行优化。如果你需要其他的协助请联系 AIM 的技术支持工程师，

清洁:

- 如果有必要，NC512 可采用加有皂化剂的水或适当溶剂清洗剂清洗。
- 欲获得适当的清洗材料一览表，请参见AIM的免清洗剂表。

处理及存储:

- NC512在4°C-12°C (40°F-55°F) 温度下保质期为1年，13°C到22°C (55°F到72°F)的室温下保质期为3个月。
- 在使用密封焊膏之前，使焊膏充分且自然的升温至室温（建议放置8小时）。
- 轻而彻底的混合该产品(最长1-2分钟)，以保证由于储存而分离的任何材料都能分布均匀。
- 请勿将新鲜的和使用过的焊膏储存在同一容器中。不使用时，要将所有打开的容器重新密封。
- 替换与500克罐子的盖子连在一起的内盖，以确保最佳的密封效果。

物理性能:

项目	规格
外观	灰色、光滑的油脂状
合金	SAC305
熔点	217°-218°C
锡粉型号	T3, T4, T5
粘度	印刷、点涂版本
包装	符合所有工业包装标准

测试数据小结:

CLASSIFICATION			
Product Name	IPC Classification to J-STD-004	Copper Mirror to J-STD-004	Silver Chromate to J-STD-004
NC512	ROLO	LOW	PASS
POWDER TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Powder Size	Type 3 – 45-25 micron Type 4 – 38-20 micron	IPC TM 650 2.2.14
2	Powder Shape	Spherical	Microscope
FLUX MEDIUM TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Acid Value	143.17 ± 5.5mg KOH/ g flux	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.13
2	Halide Content	Silver Chromate Paper - Pass	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35
3	Fluorides Spot Test	No flouride	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35.1 J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35.2
4	Corrosivity Test/ Copper Mirror	Low	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.32
5	Corrosion Flux	Pass	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.15
6	Surface Insulation Resistance	Pass – See AIM Qualification Test Report	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.3.7
7	Oxygen Bomb	Bromine 639 mg/Kg Chlorine <510 mg/Kg	EN 14582:2007 SW 9056 SW 5050
VISCOSITY TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	T-Bar Spindle Test Method	700 ± 10% kcps	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.34
SOLDER PASTE TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Tack Test	40.0 g	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.44
2	Tack Test	102.6 g	JIS Z 3284 Annex 9
3	Solder Ball Test	Pass	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.43
4	Wetting Test	Pass	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.45
5	Paste Shelf Life	Between 4° and 12° C (40° and 55° F) = 6 months	AIM TM 125-11
6	Solder Paste Slump Test	Pass	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.35

加拿大 +1-514-494-2000 · 美国 +1-401-463-5605 · 墨西哥 +52-656-630-0032 · 欧洲 +44-1737-222-258

亚太地区 +86-755-2993-6487 印度 +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com

AIM IS ISO9001:2008 & ISO14001:2004 CERTIFIED

以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由45微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入<http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx>查询AIM相关条款。